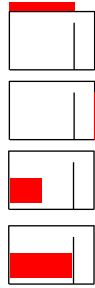


SMT

Advertising formats on www.SMT-Verlag.de

emv-esd

CADS



Type	Size in Pixel	Formats	Price per week
Super Banner	728 x 90	GIF/JPG/Flash	300 €
Wide Skyscraper	160 x 600	GIF/JPG/Flash	250 €
Rectangle	180 x 150	GIF/JPG/Flash	150 €
Medium Rectangle	300 x 250	GIF/JPG/Flash	250 €

You can book any other formats, inclusively videos.
Please don't hesitate to contact our online advertising!

Editorial contact

Dipl.-Ing. Jost Dennier
info@smt-verlag.de

Oberer Schenkgarten 1
D-55218 Ingelheim
Tel: +49 6132 4316-47
Fax: +49 6132 4316-49

Distribution

info@smt-verlag.de

Oberer Schenkgarten 1
D-55218 Ingelheim
Tel: +49 6132 4316-47
Fax: +49 6132 4316-49

Advertising

Tel: +49 6132 4316-47
Fax: +49 6132 4316-49
E-mail: info@smt-verlag.de

MEDIA INFORMATION 2016

EDITORIAL CALENDAR
CIRCULATION BREAKDOWN
ADVERTISING RATES

Fachzeitschrift für Advanced Packaging & Elektronikfertigung

SMT

emv-esd

FACHZEITSCHRIFT FÜR ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT &
AUSWIRKUNG ELEKTROSTATISCHER AUFLADUNG

CADS

CAE/CAD/CAM/CAQ

SMT | FACHZEITSCHRIFT FÜR ADVANCED PACKAGING & ELEKTRONIKFERTIGUNG
JAHRGANG 28
OKTOBER 2015
WWW.SMT-VERLAG.DE
30974

10 **SMT** + CADS 3

BECKER & MÜLLER SCHALTUNGSDRUCK GMBH –
30 JAHRE MUSTER- UND KLEINSERIENFERTIGUNG VON LEITERPLATTEN

- 3D-Inline-Röntgen (AXI) mit neuen Maßstäben
- Marktübersicht Bestückssysteme
- FPGA-basiertes Design mit Gigasample-Wandlern bringt den DDC auf das Board

BECKER MÜLLER

/// Publisher: Jost Dennier
/// Editor: Jost Dennier
Address: Redaktion SMT/CADS/EMV-ESD
 Oberer Schenkgarten 1
 D-55218 Ingelheim
 Tel.: +49 61 32 43 16 47
 Fax: +49 61 32 43 16 49
 E-Mail: info@smt-verlag.de
/// Advertising: Telefon: +49 613 2 43 16 47,
Address: Fax: +49 61 32 43 16 49
 E-Mail: info@smt-verlag.de
/// Owner: Jost Dennier
/// Verlag: SMT-VERLAG
 Oberer Schenkgarten 1
 D-55218 Ingelheim
/// Volume: 29. Jahrgang 2016
/// Publikation Dates 8 times a year
/// Editorial features: see page 5 and 6
/// Subsrption rates: per year: SMT 58,00 Euro incl. Postage
 single copy: 9,00 Euro
 per year: EMV-ESD or CADS 29,00 Euro incl Postage

/// In Brief:

»SMT Germany« with a qualified circulation covers all aspects of electronics manufacturing and testing, with special emphasis on Surface Mount Technology and Advanced Packaging.
 Topics are:
 • Board Assembly
 • Printed Circuit Board Manufacturing
 • Production Techniques in Microelectronics
 • Test and Measurement
 • Market Surveys on the most important products and services
 • Design
 The qualified readers are engineers and technical management involved in the production, assembly, test, QA and inspection of PCBs, who are directly responsible in the specification and purchase of electronic products and services.
EMV-ESD covers all aspects of electromagnetic compatibility (EMC) and the effects of electrostatic discharge (ESD)
CADS serves the computer-aided design industry in electronics and includes topics like verification, routing, signal integrity etc.

/// Printed volume: 9500
/// Current Total circulation : 9308
/// Subscription Circulation: 838
/// Free Samples 8212
/// Rest copies, archives: 258

/// Geographical Breakdown

Area	Copies	%
Germany		
Postal Code 0	221	2,4
Postal Code 1	331	3,6
Postleitzahl 2	507	5,4
Postal Code 3	715	7,7
Postal Code 4	621	6,7
Postal Code 5	752	8,1
Postal Code 6	1131	12,2
Postal Code 7	1992	21,4
Postal Code 8	1607	17,3
Postal Code 9	823	8,8
Foreign Countries		
Switzerland	181	1,9
Austria	112	1,2
UK	83	0,9
Netherlands	81	0,9
Others	151	1,6
Total	9308	100,0

Breakdown by type of business

Classification	Receivers	Copies	%
242	Maschine Tool	639	6,9
243	Data processing/ office machinery	159	1,7
244	Automobile	247	2,7
248	Aeronautics	288	3,1
250	Elektronikfertigung	3751	40,3
	Consumer electronics	172	1,8
	Medical electronics	316	3,4
	PCB Manufacturer	243	2,6
	Engineering Offices	1251	13,4
	Test and Measurement	417	4,5
5	Telecommunication / Traffic	836	9,0
	Component Manufacturer	241	2,6
	Power supply	58	0,6
9	Highschools /Education	622	6,7
	others	68	0,7
Total circulation		9308	100,0

Size of companies

Employees	Copies	%
1 bis 9	1491	16,0
10 bis 49	1153	12,4
50 bis 99	781	8,4
100 bis 499	2286	24,6
500 bis 999	838	9,0
1000 and more	2759	29,6
Total	9308	100

Job Function

	Copies	%
Commercial Management	610	6,6
Techn. Management	2181	23,4
Research / development	2512	27,0
Konstruktion	718	7,7
Manufacturing	1981	21,3
QA, Test	535	5,7
Purchasing	304	3,3
Sales / Marketing	400	4,3
Student	42	0,5
Universities/others	25	0,3
	9308	100,0

Zeitschriftenformat: DIN A4 210 Width x 297 Height mm
Bleed of page 216 Width x 303 Height mm

Satzspiegel: 185 Width x 260 Height mm

Anzeigenformate und Grundpreise: Prices in Euro

Format	Width x Height	Bleed	ads per year	1x	2x	4x	6x	8x
1/1- Seite	185 x 260	216 x 303		3.400,00	3.200,00	3.000,00	2.800,00	2.700,00
3/4- Seite	140 x 260 oder 185 x 195	146 x 303		2.900,00	2.600,00	2.500,00	2.300,00	2.200,00
2/3- Seite	123 x 260 oder 185 x 173	129 x 303		2.500,00	2.400,00	2.200,00	2.100,00	2.000,00
1/2 Juniorpage	135 x 195	138 x 198		2.100,00	2.000,00	1.900,00	1.800,00	1.700,00
1/2- Seite	93 x 260 oder 185 x 130	96 x 303 oder 216 x 133		1.900,00	1.800,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00
1/3- Seite	62 x 260 oder 185 x 87	65 x 303 oder 216 x 90		1.450,00	1.250,00	1.150,00	1.100,00	1.050,00
1/4- Seite	46 x 260 oder 185 x 62 oder 93 x 130	96 x 133 oder 216 x 65 oder 49 x 303		1.030,00	980,00	920,00	880,00	820,00
1/8- Seite	46 x 130 oder 93 x 62 oder 185 x 33	49 x 133 oder 96 x 65 oder 216 x 36		530,00	504,00	474,00	440,00	430,00
1/16-Seite	46 x 62 oder 93 x 31			360,00	340,00	324,00	303,00	285,00

special positions: Inside / Outside cover +15%
others +10%

Extra charges for colours:

Format	2-colour	3-colour	4-colour	special colour
1/1 or smaller	390,00	750,00	950,00	600,00
1/2 or smaller	300,00	580,00	750,00	600,00
1/4 or smaller	250,00	450,00	550,00	600,00

Classified advertising rates

per column, 42 mm Width, millimeter line € 3,00

Bank:

Jost Dennier Mainzer Volksbank Kto.-Nr.: 787 587 013 BLZ: 551 900 00
BIC-Code: MVBMD55 IBAN: DE83551900000787587013

Payment conditions: within 10 Tagen 2% discount - 20 days net

Bound Inserts:

Paperweight: 80 bis 120 g/m²

1 sheet (2 pages)	2 sheet	3 sheet	4 sheet
3 450,00	4 990,00	6 610,00	8 240,00

Inserts:

up to 25 g/1000 incl. Porto up to 50 g/1000 incl. Port
270,00 @ 370,00 €

Print: Offset

Electronic files: PDF, TIFF, EPS, JPG, GIF etc.

Address: SMT-Verlag, Oberer Schenkgarten 1,
D-55218 Ingelheim, Tel: +49 6132 431647, Fax: +49 6132 431649,
E-Mail: info@smt-verlag.de

Termine	Schwerpunktthemen SMT	Schwerpunkte CADS	Schwerpunkte EMV-ESD	Fairs
Ständige Schwerpunkte	Advanced Packaging Baugruppenfertigung Leiterplattenfertigung Test- und Qualitätssicherung Marktübersichten	EDA, Leiterplatten- und Baugruppendesign, Entwurfswerkzeuge, Logikanalyse, -synthese, Simulation	Normung, Messen/Prüfen, Schirmung, Filter, Antennen, Überspannungsschutz, Elektrostatische Entladungen	
January/February mit EMV-ESD 1 FAIR ISSUE EMV 2016 Editorial Due Date 05.02.2016 Ad Closing Date 10.02.2016 Publication Date 16.02.2016	Packaging, Bonding AOI, AXI, Flying Prober Reparatur/Rework, Löttechnik, Bestücktechnik, Photovoltaik CSP, Flip Chip, Wafer, Reinraumtechnik Market Survey Connectors		Preliminary Reports EMV 2016 Messtechnik Filter, Stromversorgung Gehäuse ESD Störfestigkeit	APEX 15.03. - 17.03.2016 Las Vegas EMV 2016 23.02. - 25.02.2016 Düsseldorf
March mit CADS 1 Editorial Due Date 16.03.2016 Ad Closing Date 19.03.2016 Publication Date 23.03.2016	Preliminary Reports »SMT Hybrid Packaging« Baugruppentest, Halbleitertest, AOI Löttechnik, Selektiv-Löten Dispensen, Bestückung Photovoltaik-Produktion Market Survey EMS	Design, Verifikation, Platzieren, Entflechten, Signalintegrität ASIC, FPGA, PLA		CeBIT 14.03. - 28.03.2016 Hannover Hannover Messe 25.04. - 29.04.2016 Hannover
April/May mit EMV-ESD 2 FAIR ISSUE SMT/ HYBRID/ PACKAGING Editorial Due Date 06.04.2016 Ad Closing Date 13.04.2016 Publication Date 20.04.2016	Preliminary Reports »SMT Hybrid Packaging« Board-Test, ICT, AOI, AXI Packaging, Lötverfahren, Photovoltaik-Produktion Leiterplatten, Microvias, HDI Market Survey Soldering Systems		EMV-ESD-Anbieterübersicht Teil 1 Nachbericht EMV 2016 Messtechnik Antennen Stromversorgung Produktsicherheit	SMT/Hybrid/ Packaging 2016 26.04. - 28.04.2016 Nürnberg
June/July mit CADS 2 Editorial Due Date 15.06.2016 Ad Closing Date 22.06.2016 Publication Date 29.06.2016	Reports »SMT Hybrid Packaging« Bestückung Sieb-/Schablonendruck Packaging, CSP, Bonden Market Survey Screen Printing	Design, Verifikation, Platzieren, Entflechten, Signalintegrität ASIC, FPGA, PLA		inter solar 2016 22.06. - 24.06.2016 München parts2clean 2016 31.05. - 02.06.2016 Stuttgart
August/September mit EMV-ESD 3 Editorial Due Date 17.08.2016 Ad Closing Date 24.08.2016 Publication Date 31.08.2016	Bestückung, Dosiereinrichtungen Löten, AOI, AXI, Flying Prober, Testautomation Packaging, Chip-on-Board, Rework Market Survey Assembly Test Equipment		EMV-ESD-Anbieterübersicht Teil 2 Messtechnik Antistatische Materialien Dienstleistungen Störfestigkeit	
October mit CADS 3 Editorial Due Date 14.09.2016 Ad Closing Date 21.09.2016 Publication Date 28.09.2016	Preliminary Reports »electronica« AOI, AXI, Flying Prober, Testautomation Packaging, Chip-on-Board, Rework, Bestücktechnik, Schablonendruck Market Survey Placement Machines	Design, Verifikation, Platzieren, Entflechten, Signalintegrität ASIC, FPGA, PLA		Semicon Europe 25.10. - 27.10.2016 Grenoble
November mit EMV-ESD 4 Fair Issue »electronica 2016« Editorial Due Date 19.10.2016 Ad Closing Date 26.10.2016 Publication Date 02.11.2016	Preliminary Reports »electronica« Testsysteme, Lötssysteme Packaging, Bestückung, Schablonendruck, Photovoltaik Löttechnik, Lotpasten, neue Trends Market Survey PCB Manufacturer		Laboreinrichtungen ESD, Überspannung Störfestigkeit Antennen Messtechnik Produktsicherheit	Motek 2016 10.10. - 13.10. 2016 Stuttgart electronica 2016 08.11. - 11.11.2016 München
December mit CADS 4 Editorial Due Date 30.11.2016 Ad Closing Date 07.12.2016 Publication Date 14.12.2016	Reports »electronica« Boardhandling, Bonding Löttechnik, Bestücktechnik Packaging, Underfill, Bonding Testautomation, Boundary Scan Market Survey Bond Systems	Design, Verifikation, Platzieren, Entflechten, Signalintegrität ASIC, FPGA, PLA		SPS/IPC/DRIVES 2016 22.11 - 24.11.2016 Nürnberg